

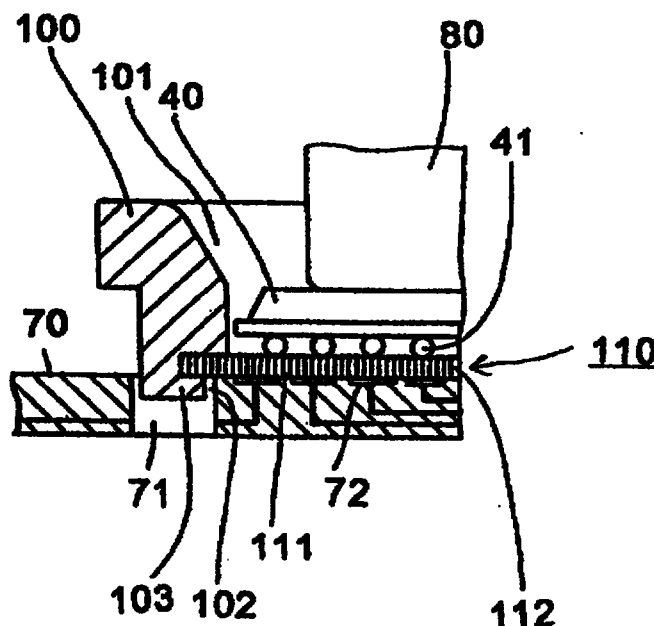
世界知的所有権機関
国際事務局



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 G01R 31/26, H01L 21/66	A1	(11) 国際公開番号 WO98/07041 (43) 国際公開日 1998年2月19日(19.02.98)
(21) 国際出願番号 PCT/JP97/02788 (22) 国際出願日 1997年8月8日(08.08.97) (30) 優先権データ 特願平8/211584 1996年8月9日(09.08.96) (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 アドバンテス (ADVANTEST CORPORATION)[JP/JP] 〒179 東京都練馬区旭町一丁目32番1号 Tokyo, (JP) (72) 発明者: および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 伊藤明彦(ITO, Akihiko)[JP/JP] 〒348 埼玉県羽生市東5丁目2-35 Saitama, (JP) 小林義仁(KOBAYASHI, Yoshihito)[JP/JP] 〒361 埼玉県行田市桜町1-11-6 Saitama, (JP) (74) 代理人 弁理士 草野 卓, 外(KUSANO, Takashi et al.) 〒160 東京都新宿区新宿四丁目2番21号 相模ビル Tokyo, (JP)		(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO特許 (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 添付公開書類 国際調査報告書
(54)Title: SEMICONDUCTOR DEVICE TESTING APPARATUS (54)発明の名称 半導体デバイス試験装置 (57) Abstract A semiconductor device testing apparatus which does not need to change an IC socket with another even when the kind of IC package is changed. A bottom portion of a device storage carrier (100) in which IC's to be tested are stored is opened, and a conductive thin wire-buried member (110) comprising an elastic rubber plate (111), and a large number of conductive thin wires (112) buried in a mutually insulated state in the rubber plate so that these wires extend in the direction of the thickness of the rubber plate and are exposed at both end portions thereof to the outside of both surfaces of the rubber plate is fixed to the opened bottom portion of the device storage carrier, IC's to be tested being placed on this conductive thin wire-buried member. A board (70) provided with gold pads (72), which are formed in a mutually insulated state, is fixed to a test head in positions thereof which correspond at least to the terminals of the IC's to be tested placed on the upper surface of the conductive thin wire-buried member. When the IC's are tested in a test section (21), the lower surface of the conductive thin wire-buried member is brought into contact with the board, and the terminals of these IC's to be tested and the corresponding conductive pads on the board are thereby connected together electrically through the conductive thin wires.		



(57) 要約

ICパッケージの種類が変更されても、ICソケットを交換する必要をなくした半導体デバイス試験装置を提供する。被試験ICを収納するデバイス収納キャリア100の底部を開放し、このデバイス収納キャリアの開放底部に、弾性を有するゴム板111と、このゴム板の厚み方向に互いに絶縁状態で、かつ両端部が前記ゴム板の両面に露出した状態に、埋設された多数本の導電性細線112とから構成された導電性細線埋設部材110を取り付け、この導電性細線埋設部材上に被試験ICを載置する。少なくとも前記導電性細線埋設部材の上面に載置された被試験ICの各端子と対応する位置に、金パッド72が互いに絶縁状態で形成されたボード70をテストヘッドに取り付け、テスト部21における被試験ICの試験時に、前記導電性細線埋設部材の下面を前記ボードに接触させ、被試験ICの各端子と前記ボードの対応する導電体パッドとを前記導電性細線を通じて互いに電気的に接続する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を特定するために使用されるコード (参考情報)

AL	アルバニア	ES	スペイン	LK	スリランカ	SE	スウェーデン
AM	アルメニア	FI	フィンランド	LR	リベリア	SG	シンガポール
AT	オーストリア	FR	フランス	LS	レソト	SI	スロヴェニア
AU	オーストラリア	GA	ガボン	LT	リトアニア	SK	スロヴァキア共和国
AZ	アゼルバイジャン	GB	英国	LU	ルクセンブルグ	SL	シエラレオネ
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GE	グルジア	LV	ラトヴィア	SN	セネガル
BB	バルバドス	GH	ガーナ	MC	モナコ	SZ	スワジランド
BE	ベルギー	GM	ギニア	MD	モルドヴァ共和国	TD	チャード
BF	ブルキナ・ファソ	GN	ギニアビサウ	MG	マダガスカル	TG	トーゴ
BG	ブルガリア	GR	ギリシャ	MK	マケドニア共和国	TJ	タジキスタン
BJ	ベナン	HU	ハンガリー		ラヴィア共和国	TM	トルクメニスタン
BR	ブラジル	ID	インドネシア	ML	マリ	TR	トルコ
BY	ベラルーシ	IE	アイルランド	MN	モンゴル	TT	トリニダード・トバゴ
CA	カナダ	IL	イスラエル	MR	モーリタニア	UA	ウクライナ
CF	中央アフリカ共和国	IS	アイスランド	MW	マラウイ	UG	ウガンダ
CG	コンゴ	IT	イタリア	MX	メキシコ	US	米国
CH	スイス	JP	日本	NE	ニジェール	UZ	ウズベキスタン
CI	コート・ジボアール	KE	ケニア	NL	オランダ	VN	ベトナム
CM	カメルーン	KG	キルギスタン	NO	ノルウェー	YU	ユーゴスラビア
CN	中国	KP	朝鮮民主主義人民共和国	NZ	ニュージーランド	ZW	ジンバブエ
CU	キューバ	KR	大韓民国	PL	ポーランド		
CZ	チェッコ共和国	KZ	カザフスタン	PT	ポルトガル		
DE	ドイツ	LC	セントルシア	RO	ルーマニア		
DK	デンマーク	LI	リヒテンシュタイン	RU	ロシア連邦		
EE	エストニア			SD	スーダン		